

DIN EN 61837-3

ICS 31.240

Ersatz für
DIN EN 61837-3:2001-09
Siehe Anwendungsbeginn

**Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur
Frequenzstabilisierung und -selektion –
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse –
Teil 3: Metallgehäuse
(IEC 61837-3:2015);
Deutsche Fassung EN 61837-3:2015**

Surface mounted piezoelectric devices for frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 3: Metal enclosures
(IEC 61837-3:2015);
German version EN 61837-3:2015

Dispositifs piézoélectriques à montage en surface pour la commande et le choix de la
fréquence –
Encombres normalisés et connexions des sorties –
Partie 3: Enveloppes métalliques
(IEC 61837-3:2015);
Version allemande EN 61837-3:2015

Gesamtumfang 24 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE

Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2015-05-20 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm ist 2016-04-01.

Für DIN EN 61837-3:2001-09 besteht eine Übergangsfrist bis 2018-05-20.

Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 61837-3:2013-05.

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 642 „Piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung und -selektion“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 49 „Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „<http://webstore.iec.ch>“ zu dieser Publikation angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich, soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61837-3:2001-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Für die Gehäusezeichnung wird festgelegt, dass ein Zeichnungssatz vier Ansichten umfasst: die Draufsicht, die Vorderansicht, die Seitenansicht von rechts und die Ansicht von unten. In der vorherigen Ausgabe war die Angabe der Seitenansicht von rechts wahlfrei.
- b) Die Gehäusehöhe entfällt in dieser Ausgabe; stattdessen wird die Gesamthöhe mit dem Symbolbuchstaben G oder mit G und einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl angegeben.
- c) Die Abstände der Anschlüsse zueinander müssen von Mitte zu Mitte angegeben werden, wobei das Grundmaß e $2,54 \times n$ mm (n ist eine ganze Zahl) bzw. $1,27 \times n$ mm bei Gehäusemaßen kleiner als 6 mm beträgt. Entspricht der Abstand zwischen den Anschlüssen keinem Vielfachen des Grundmaßes, dann ist e mit einer zusätzlichen tiefgestellten Zahl anzugeben. Gibt es mehrere Abstandswerte, müssen der tiefgestellten Zahl ein Bindestrich und eine Zahl folgen.
- d) Die Maße der Anschlussflächen, die in der vorherigen Ausgabe von IEC 61837-3 mit den Mindestwerten angegeben wurden, werden nun zur Vereinfachung für den Verbraucher mit den Maximalwerten angegeben.

- e) Gibt es mehrere identische Gehäuse mit unterschiedlicher Höhe, wird jedes Gehäuse mit einem Schrägstrich (/) und einer zweistelligen Zahl hinter der Bezeichnung der Grundbauform angegeben. Die Bezugskennzeichnungen werden in der Tabelle im Datenblatt angegeben.
- f) Die Gehäusekonfigurationen wurden überarbeitet, wie in Tabelle 1 angegeben.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61837-3: 2001-09

– Leerseite –

Oberflächenmontierbare piezoelektrische Bauteile zur Frequenzstabilisierung
und -selektion –
Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse –
Teil 3: Metallgehäuse
(IEC 61837-3:2015)

Surface mounted piezoelectric devices for
frequency control and selection –
Standard outlines and terminal lead connections –
Part 3: Metal enclosures
(IEC 61837-3:2015)

Dispositifs piézoélectriques à montage en
surface pour la commande et le choix de la
fréquence –
Encombrements normalisés et connexions des
sorties –
Partie 3: Enveloppes métalliques
(IEC 61837-3:2015)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2015-05-20 angenommen. CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

© 2015 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Ref. Nr. EN 61837-3:2015 D

Europäisches Vorwort

Der Text des Dokuments 49/1118/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe der IEC 61837-3, erarbeitet vom IEC/TC 49 „Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection and detection“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 61837-3:2015 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2016-06-04
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2018-05-20

Dieses Dokument ersetzt EN 61837-3:2000.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61837-3:2015 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden Anmerkungen einzutragen:

IEC 60122-3:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60122-3:2010 (nicht modifiziert).
IEC 60191-6:2009	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60191-6:2009 (nicht modifiziert).
IEC 60368-1:2000 A1:2004	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60368-1:2000 (nicht modifiziert). A1:2004
IEC 60368-2-2:1996	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60368-2-2:1999 (nicht modifiziert).
IEC 60368-3:2010	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60368-3:2010 (nicht modifiziert).
IEC 60679-1:2007	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60679-1:2007 (nicht modifiziert).
IEC 60679-3:2012	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60679-3:2013 (nicht modifiziert).
IEC 60862-1:2003	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60862-1:2003 (nicht modifiziert).
IEC 60862-2:2012	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60862-2:2012 (nicht modifiziert).
IEC 60862-3:2003	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN 60862-3:2003 (nicht modifiziert).
ISO 1101:2012	ANMERKUNG	Harmonisiert als EN ISO 1101:2013 (nicht modifiziert).

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Konfiguration der Gehäuse	4
4 Bezeichnung der Bauformen	4
5 Maße der Metallgehäuse	5
6 Anschlussbelegungen	5
7 Bezeichnung der Metallgehäuse	5
Literaturhinweise	19
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren entsprechenden europäischen Publikationen	20
Tabellen	
Tabelle 1 – Überarbeitete Konfiguration	5
Tabelle 2 – Bezeichnung der Metallgehäuse	6

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61837 behandelt Norm-Gehäusemaße und Anschlüsse, wie sie für oberflächenmontierbare Bauelemente (SMDs) zur Frequenzstabilisierung und -selektion in Metallgehäusen gelten. Er basiert auf IEC 61240, in der Gestaltungsregeln für Gehäusezeichnungen von oberflächenmontierbaren Bauelementen genormt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

IEC 61240:2012, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules*

3 Konfiguration der Gehäuse

Die Gehäuse der oberflächenmontierbaren Bauteile sind aus Metall hergestellt, wobei ihre geformten Anschlüsse auf dem beschreibenden Kennzeichnungssystem für Halbleitergehäuse basieren.

Bei den in diesem Teil von IEC 61837 beschriebenen SMD-Gehäusen handelt es sich in allen Fällen um spezielle oberflächenmontierbare Bauformen. Daher wird folgende Kennung verwendet:

- SMS (Surface-Mounted, Special).

4 Bezeichnung der Bauformen

Die Bauformkennung setzt sich aus den folgenden vier Teilen zusammen:



A: Konfigurationssymbol der Gehäuse:

- SMS (Surface-Mounted, Special).

B: Struktur der Anschlussdrähte:

- L: Bauform mit gefalzten Anschlüssen;
- J: Bauform mit gefalzten Anschlüssen.

Unbedrahtete Bauformen haben keine Kennzeichnung.

Siehe IEC 61240:2012, Abschnitt 3, Einteilung der SMD-Gehäuse.

C: Anzahl der Anschlüsse;

D: zweistellige Seriennummer.